AR5480双层胶金属电极剥离工艺实验流程单

工艺大步	序号	工艺步骤	细节步骤	设备	工程师	片数	备注	版图要求
备片信息	00	备片	来料晶圆检查	金相显微镜/Olympus MX-51（设备号11001102）	—	—	确认客户样品材料、尺寸、厚度、正反面、表面洁净度及是否已有底层薄膜	确认金属电极区域、Pad位置、划片道及禁布区
制版/图形准备	01	版图确认	GDS/版图数据检查	版图设计软件	尹长青	—	确认金属电极图形、线宽、间距、Pad尺寸、对准标记及套刻层关系	增加测试电极、开短路结构、线宽/间距监控图形；线宽/间距≥8 μm；线条最大尺寸≤500 μm
	01	光刻版制作（可选）	掩膜版制作/激光直写版图准备	DWL66+激光直写（设备号17002190）	尹长青	—	若采用无掩膜激光直写，可不制作实体掩膜版	版图需包含对准标记、工艺测试图形及样品编号标识
晶圆清洗	02	清洗	有机清洗	8槽清洗机	宗莉	—	清洗方式需与客户样品材料及已有薄膜兼容	无特殊版图要求
光刻	03	前处理	水分去除	HMDS烘箱	付玉霞	—	用于提高光刻胶与Si、SiO_2、SiNx、玻璃等表面的附着力，减少显影、金属沉积和剥离过程中的胶边翘起或图形脱落。若样品表面已有有机层、二维材料、聚合物或温度敏感材料，需确认是否允许HMDS和加热处理	无特殊版图要求
	03	涂底层胶	AR5480底胶涂覆	SUSS Labspin匀胶机	付玉霞	—	AR5480成本低于LOR系列；溅射金属厚度小于底胶厚度的0.7倍。适用于金属厚度≤250nm的金属，溅射金属优先选择此方案	线宽/间距≥8 μm，线条最大尺寸≤500 μm，适用于大Pad、宽线条、粗间距图形
	03	底胶前烘	Soft bake	SUSS Hot热板	付玉霞	—	底胶烘烤不足会导致显影不稳定；过烘可能影响底胶溶解速率和undercut形成	无特殊版图要求
	03	涂顶层胶	AZ601正胶涂覆	SUSS Labspin匀胶机	付玉霞	—	顶胶用于定义光刻图形；需保证顶胶覆盖均匀、无颗粒、无针孔。实际胶厚按设备和胶液批次确认	确认最小线宽、Pad尺寸、对准标记与胶厚匹配
	03	底胶前烘	Soft bake	SUSS Hot热板	付玉霞	—	顶胶前烘影响显影窗口和边缘质量；避免过烘导致显影困难或底胶undercut不足	无特殊版图要求
	03	曝光	对准曝光	SUSS MA8（LED）光刻机（设备号25032843）	付玉霞	—	若为多层工艺，需进行对准标记识别和套刻检查；曝光剂量不足会导致开口不完整，过曝可能影响CD和undercut。实际剂量需按胶厚、设备光强和版图尺寸微调	确认曝光层次、对准方向、关键图形和测试结构是否正确
	03	显影	图形显影	PD238显影液	付玉霞	—	要求开口完整、边缘清晰、无明显残胶；小间距和大Pad区域均需检查	重点检查最小线宽、Pad开口、对准标记和测试图形
镜检	04	镜检	图形完整性和尺寸检查	金相显微镜/Olympus MX-51（设备号11001102）	付玉霞，包艳琳	—	检查电极开口、线条连续性、边缘质量、缺胶、残胶和套刻情况	记录关键区域、测试图形和异常位置
	04	剖面观察	胶剖面/undercut确认	高分辨场发射扫描电镜 / Zeiss GeminiSEM 300（20009957）（可选）	陈雅璐	—	该步骤可选，一般用于首次建立工艺或关键尺寸/厚金属剥离前确认。	SEM测试图形尺寸：≥10 μm宽*5000 μm长
打底胶	05	沉积前处理	Descum	等离子体去胶机（设备号21013080）	李希有	—	去除残胶和表面吸附物，提高金属粘附；避免损伤敏感材料和已形成图形	无特殊版图要求。
金属沉积	06	金属沉积	溅射金属	国产溅射台（设备号2011815）	魏治乾	—	沉积Ti/Au、Cr/Au、Ti/Pt/Au、Ti/Pt、Cr/Pt、Ni/Au等金属体系。双层胶特别适合溅射金属剥离，但仍需控制沉积方向性、膜厚、温升和台阶覆盖。厚金属、大面积连续金属或强附着金属需评估剥离难度	确认金属材料、粘附层、总厚度、沉积方式、Pad尺寸和是否允许金属污染。
剥离	07	Lift-off	溶剂浸泡剥离	NMP/丙酮	宗莉	—	优先采用NMP浸泡剥离，避免强超声损伤细线和小Pad	厚金属或大面积金属需延长浸泡时间
	07	终清洗	去除表面残余物	IPA/DI水/N_2吹干	宗莉	—	避免金属颗粒、胶渣和水痕残留	无特殊版图要求
剥离后检查	08	镜检	金属图形检查	金相显微镜/Olympus MX-51（设备号11001102）	包艳琳	—	检查金属电极完整性、断线、短路、毛刺、金属残留和Pad形貌	记录缺陷类型、位置和数量
	08	形貌/厚度检查	金属厚度与台阶检查	P7 台阶仪（设备号21012469）	苏鑫	—	测量金属厚度、边缘台阶、线宽变化和表面粗糙度	预留宽度≥50 μm、长度≥500 μm的金属台阶测试区；关键电极设置开短路和线宽监控结构
最终确认	09	结果汇总	数据记录	数据整理	—	—	汇总光刻、金属沉积、剥离、镜检和可选电学测试结果	交付样品、照片及测试结果

注：1. 若后续需要划片工艺，请参考退火工艺流程卡和砂轮划片工艺流程卡。

2. 本流程卡基于4英寸晶圆制定，其他尺寸晶圆/小片/异形片的工艺参数、设备适配、装片方式、均匀性与风险均会调整，需专项评估。

3. 本流程卡适用于双层AR5480底胶溅射金属电极剥离（Lift-off）、最小间距8um的短流程加工。